Issue Comment ★★★★★

프로텍 (053610)

박장욱

jangwook.park@daishin.com

투자의견

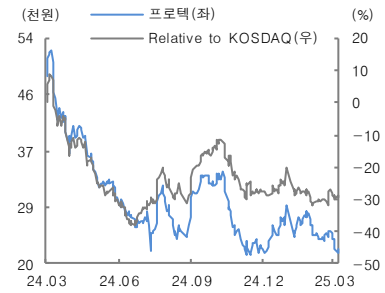
6개월 목표주가

현재주가 (25.04.02) 22,000

스몰캡업종

KOSDAQ	691.45
시가총액	2,448억원
시가총액비중	0.07%
자본금(보통주)	55억원
52주 최고/최저	52,200원 / 21,150원
120일 평균거래대금	11억원
외국인지분율	2.50%
주요주주	최승환 외 1 인 30.50% 엘파텍 14.85%

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	-8.1	1.8	-27.3	-57.4
상대수익률	-1.1	-0.1	-19.7	-43.8



영업실적 및 주요 투자지표 (단위: 억원, 원, %)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	1,988	1,561	1,702	1,764	1,958
영업이익	601	174	134	258	323
세전순이익	560	220	200	301	363
총당기순이익	423	171	128	235	283
지배지분순이익	422	206	128	235	283
EPS	4,686	2,290	1,424	2,613	3,148
PER	4.5	19.9	15.3	9.4	7.8
BPS	24,506	25,963	26,791	28,591	30,828
PBR	0.9	1.8	0.8	0.8	0.7
ROE	16.2	7.4	4.4	7.7	8.7

주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출
자료: 프로텍, 대신증권 Research Center

신규장비 레이저본더 양산을 기다리며

- 어드밴스드 공정향 고성능 디스펜서 출하량 증가로 소폭의 매출 성장
- 동사의 주가 트리거가 될 신규장비 레이저 본더
- 주요 자회사 적자폭 축소로 25년 예상 P/E F 9.4배 전망

HBM 등 어드밴스드 공정에도 사용되는 디스펜서 장비

동사의 매출은 24년 기준. 디스펜서 및 레이저 리플로우 장비 65%, 공압실린더 등 17%, 프로브카드 12%, 기타 5%로 구성됨. 주력 제품인 디스펜서 장비는 반도체 본딩 과정 중 언더필 과정에 사용됨. 디스펜서는 기존의 레거시 공정뿐 아니라 2.5D 패키징에서 칩과 인터포져를 연결해주는 어드밴스드 공정에서도 사용됨. 레거시 시장의 부진은 지속되나, 어드밴스드 시장이 지속적으로 성장함에 따라 믹스개선으로 24년 디스펜서 및 레이저 리플로우 부문 매출액은 1,310 억원(+ YoY 21.6%)으로 성장했으나, 영업이익 218억원(+ 1.8%)은 고정비 부담으로 소폭 회복에 그침

주가의 트리거가 될 신규장비 레이저 본더

동사는 레이저 기술을 활용하여 레이저 리플로우 장비를 납품 중. 레이저 리플로우는 기존의 본딩 과정에서 범프를 녹이는 리플로우 장비의 열원을 열풍에서 레이저로 대체하는 기술임. 반도체 미세화와 적층 공정이 진행됨에 따라서 웨이퍼 휨 현상(Warpage) 등이 부각 받게됨. 레이저 리플로우 등을 포함해 미세화 공정의 수행이 가능한 레이저 기술의 필요성이 커지고 있음

동사는 여기서 더 나아가 레이저 리플로우와 본딩까지 같이 수행하는 레이저 본더 장비를 개발해 해외 파운드리 회사에 24년도에 데모를 납품하였음. 레이저 본더장비는 범프 뿐 아니라 다양한 접합재나 기판 재질의 국소적 녹임, 융착, 합착을 통해 본딩 과정까지 수행이 가능한 장비임. TC본더와 경쟁관계에 있는 장비임. 기존의 디스펜서 장비 시장의 시장규모가 1조원 인데 반해, 레이저 본더 장비 타겟 시장규모는 3조원 규모에 달함

25년 매출액 1,764억원(+YoY 3.6%), 영업이익 258억원(+ 92.5 %)

25년은 어드밴스드 패키징을 중심으로 디스펜서 및 레이저 리플로우 시장이 회복됨에 따라 매출액 및 영업이익의 소폭의 성장을 예상함. 다만, 주요 고객사향 2D 낸드 프로브카드 납품 지연으로 24년 대규모 적자(-131억원)을 기록했던 주요 자회사인 피엠티의 적자폭 축소에 따른 영업이익 회복을 예상함. 2D 낸드 프로브카드는 25년 2분기에서 3분기 사이에 납품 시작이 기대됨

레이저본더를 제외해도 영업이익 정상화 고려시, 제한적인 밸류부담

기존 사업부문의 실적이 정상화되는 가운데, 레이저 본더의 본격적인 양산 여부에 따라 향후 동사의 주가의 향방이 정해질 것. 반도체의 미세화와 적층이라는 공정 기술 트렌드를 고려한다면, 레이저 기반의 기술 장비에 대한 필요성은 점차 커질 것. 동사의 10년 평균 PER이 12배 였던 점을 고려하면, 25년 P/E F 9.4배는 부담스럽지 않은 수준임

영업실적 및 주요 투자지표

(단위: 억원, 원 , %)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	1,988	1,561	1,702	1,764	1,958
영업이익	601	174	134	258	323
세전순이익	560	220	200	301	363
총당기순이익	423	171	128	235	283
지배지분순이익	422	206	128	235	283
EPS	4,686	2,290	1,424	2,613	3,148
PER	4.5	19.9	15.3	9.4	7.8
BPS	24,506	25,963	26,791	28,591	30,828
PBR	0.9	1.8	0.8	0.8	0.7
ROE	16.2	7.4	4.4	7.7	8.7

주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출 / 자료: 프로텍, 대신증권 Research Center

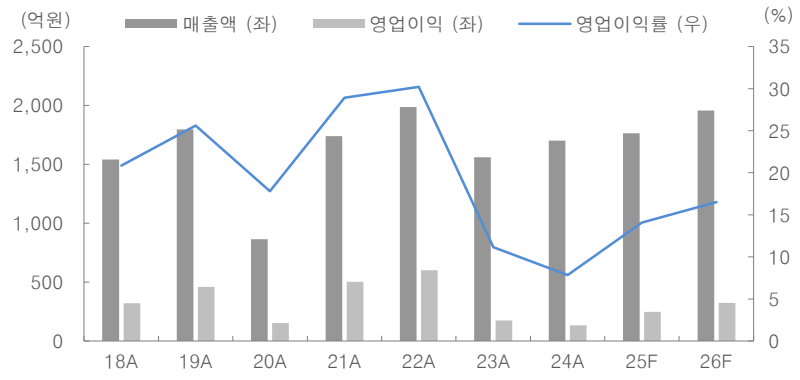
표 1. 프로텍 분기 및 연간 실적 추이 및 전망

(단위: 억원)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	23A	24A	25F	26F
매출액	**248**	**378**	**358**	**578**	**253**	**526**	**431**	**431**	**1,561**	**1,702**	**1,764**	**1,958**
YoY(%)	-41.2	-34.3	-13.9	0.3	2.1	39.3	20.5	-25.4	-21.5	9.1	3.6	11.0
매출 총이익	**78**	**124**	**96**	**149**	**3**	**186**	**101**	**101**	**447**	**392**	**503**	**587**
YoY(%)	-52.0	-46.9	-45.0	-30.0	-96.7	49.8	5.4	-32.5	-42.9	-12.4	28.3	16.8
총이익률(%)	31.5	32.9	26.7	25.9	1.0	35.4	23.4	23.4	28.7	23.0	28.5	30.0
영업이익	**9**	**60**	**27**	**78**	**-48**	**117**	**40**	**40**	**174**	**134**	**258**	**323**
YoY(%)	-92.7	-66.8	-78.0	-54.8	적자 전환	93.9	48.7	-48.3	-71.0	-23.4	92.8	25.4
영업이익률(%)	3.6	16.0	7.6	13.5	-18.8	22.3	9.3	9.3	11.2	7.8	14.6	16.5
세전이익	**35**	**80**	**42**	**64**	**-15**	**135**	**11**	**39**	**220**	**200**	**301**	**363**
YoY(%)	-75.0	-61.9	-75.7	67.0	적자 전환	69.6	-74.4	-38.5	-60.7	-9.1	50.5	20.5
세전이익률(%)	14.1	21.1	11.8	11.0	-5.8	25.7	2.5	9.1	14.1	11.8	17.1	18.5
당기순이익	**22**	**54**	**35**	**60**	**-14**	**105**	**7**	**34**	**206**	**128**	**235**	**283**
YoY(%)	-80.0	-66.4	-73.8	193.7	적자 전환	96.1	-80.6	-43.1	-51.1	-37.8	83.5	20.5
순이익률(%)	8.7	14.2	9.8	10.5	-5.4	20.0	1.6	8.0	13.2	7.5	13.3	14.5

자료: 프로텍, 대신증권 Research Center 추정

그림 1. 프로텍 연도별 매출액 및 영업이익 추이 및 전망



자료: 프로텍, 대신증권 Research Center 추정

반도체 본딩 공정

주력 장비 반도체 디스펜서 장비. 언더필 공정에 주로 사용됨

동사는 반도체 후공정 중 본딩 공정과 관련한 장비 사업을 주력 사업으로 영위 중에 있다. 본딩 공정은 패키징까지 끝난 칩을 기판과 연결하는 공정을 이야기한다. 동사의 현재 주력 장비인 디스펜서 장비는 기판과 칩을 솔더블로 연결한 이후, 빈공간을 메꾸어주는 언더필 공정에 사용된다.

플립칩 공정에 주로 사용되는 언더필 공정

언더필 공정은 다양한 본딩 공정 중 솔더블 플립칩 공정에 주로 사용된다. 플립칩은 칩을 뒤집었다는 의미로 쓰인다. 기존의 와이어링 공정은 제조가 완성된 칩의 외면에 와이어를 통해서 기판과 연결했다. 솔더블 플립칩은 I/O 역할을 하는 솔더블을 칩 위에 올려서 부착한 다음에 칩을 뒤집어서(Flip Chip) 리플로우 공정을 통해서 기판과 연결하는 방식을 사용한다.

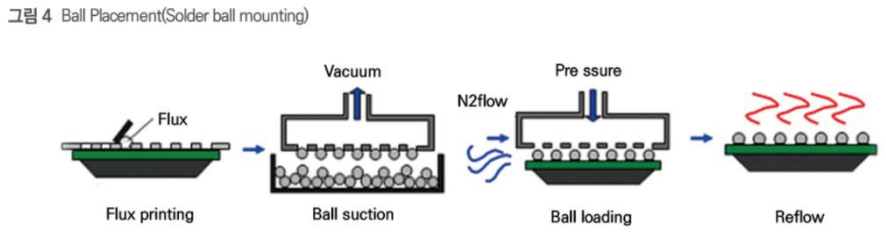
언더필은 리플로우 이후, 칩과 기판이 연결된 범프 사이의 빈공간을 메꾸어주는 역할임

이 때, 솔더블과 기판을 연결하기 위해서 열을 가해주어야 하는데, 이 때 열을 가해주는 장비가 리플로우(Reflow) 장비다. 리플로우 장비로 솔더블에 열을 가해서 솔더블이 녹으면서 기판과 연결된다. 이 때 빈틈이 생기는데, 이 빈틈을 메꾸어 주는 과정을 언더필이라고 한다. 언더필은 범프와 범프 사이의 공간을 채워준다. 이로 인해 칩과 기판 사이의 간극을 채워 기계적 강도를 높이고 전기적 연결을 보호한다. 언더필 과정이후, 이후 칩 전체를 감싸는 과정인 몰딩과정을 통해서 본딩이 완성된다. 몰딩과정에서는 EMC(Epoxy Modling Compund) 주로 사용된다.

디스펜서 업체는 미국 Nordson,유럽 Kulicke & Sofia 등이 있음

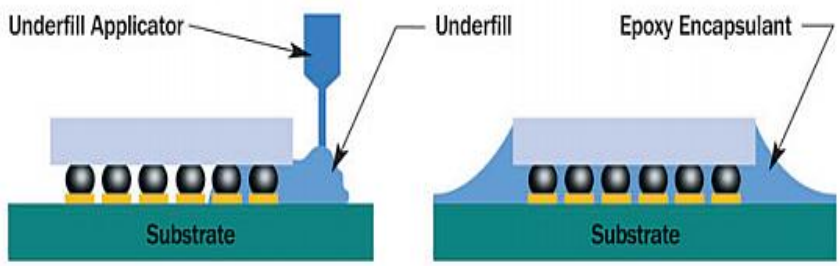
EMC는 일본의 나믹스, 독일 헨켈(Henkel)이 과점하고 있는 시장이다. 디스펜서 장비는 동사를 포함해 글로벌로 미국의 Nordson, 유럽의 Kulicke & Sofia 등의 업체들이 사업을 영위하고 있다.

그림 2. **솔더블을 이용한 본딩 과정**



자료:산업자료, 대신증권 Research Center

그림 3. **칩과 기판을 연결해주는 언더필 공정**



자료:산업자료, 대신증권 Research Center

HBM 공정에도 사용되는 디스펜서 장비

TC – NCF와 달리 MR – Reflow에서는 인터포져 연결에서 언더필 공정이 사용됨

언더필 공정은 HBM에도 사용된다. 다만, 공정별로 차이가 있다. 삼성전자의 TC-NCF 방식은 얇은 필름을 범프 밑에 깔아서 위에서부터 압착하는 방식이기 때문에 따로 언더필 공정이 필요하지 않다. 하지만, 하이닉스의 MR-Reflow 공정의 경우, 2.5D 패키징에서도 리플로우 공정이후, 칩과 인터포져의 연결, 칩과 기판의 연결에서 언더필 공정이 필요하다. 향후, 유리기판에서도 필요할 것으로 예상된다.

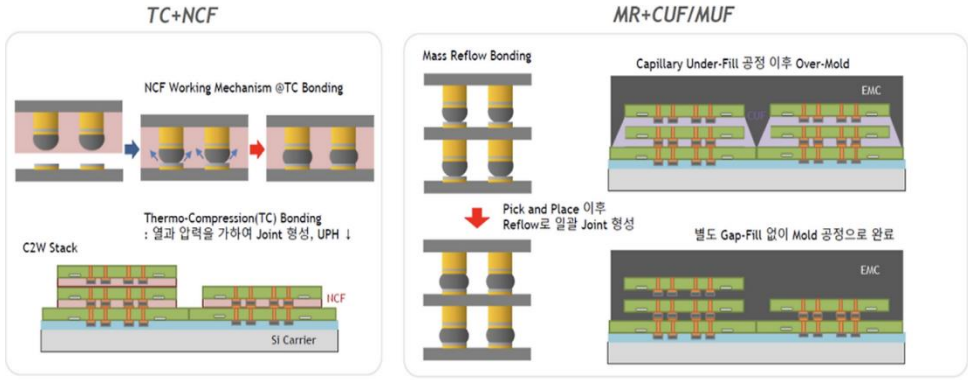
HBM에서의 공정 스텝 증가에 따른 수혜는 예상되지 않음

현재, HBM 시장을 주도하고 있는 것은 SK하이닉스로 MR-Reflow 방식이 주로 사용되고 있는 상황으로 동사는 HBM 출하량 증가에 따른 수혜가 나타나고 있다. 다만, 로직 다이에 HBM까지 적층이 완료된 칩을 기판 혹은 인터포져에 연결할 때만 사용되기 때문에, DRAM -> HBM으로 넘어감에 따른 공정 변화에 따른 수혜는 기대되지 않는다.

몰딩과 언더필이 동시에 진행되는 MUF(Molded Underfill) 방식으로 공정 혁신 진행 중

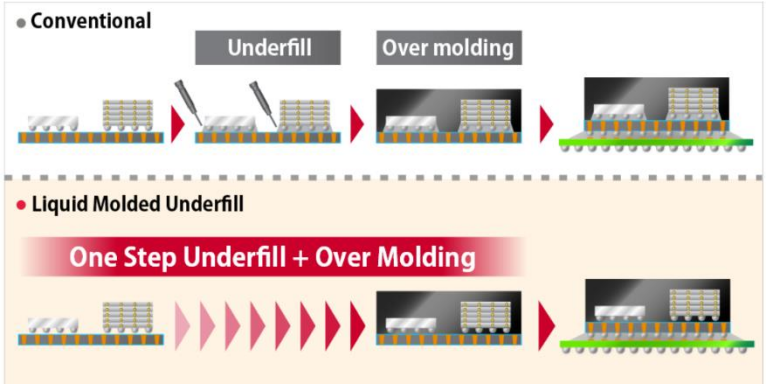
언더필 공정에서도 공정 혁신이 나타나고 있다. 전통적인 언더필 공정은 언더필 단계와 오버몰딩 단계로 2단계로 진행되는 반면, 액체 성형 언더필 공정(Liquid Molded Underfil)은 두 공정을 하나로 통합하여 공정이 이루어 진다. 액체 성형 언더필 공정은 에폭시 몰드 컴파운드(EMC) 팰릿을 약 175℃에서 용융시켜 압력을 통해 칩과 기판을 채우는 방식으로 작동한다. 기존의 언더필 재료가 상온에서 액체 상태인 반면, EMC는 고체 형태의 팰릿으로 존재해 공정의 혁신이 가능해졌다.

그림 4. TC – NCF VS MR Reflow 제조과정



자료:SK하이닉스, 대신증권 Research Center

그림 5. 언더필 공정의 혁신 – 액체성형 언더필



자료: 산업자료, 대신증권 Research Center

신규장비 – 레이저 장비

동사가 향후 성장이 예상되는 분야는 신규 장비인 레이저 본더에 있다. 레이저 본더는 레이저를 통해서 본딩(LAB: Laser Assisted Bonding)을 하는 장비를 뜻한다.

리플로우 장비를 대체하는 레이저 리플로우 장비. 칩이 점점 민감해짐에 따라 필요성이 커지는 중

동사는 일찍이 리플로우 장비를 대체하는 레이저 리플로우 장비를 개발한 바 있다. 기존의 본딩은 칩에 솔더블을 접합한 뒤, 뒤집어서 기판에 붙인 다음에 리플로우 장비를 통해서 열을 가하는 방식으로 제조되고 있다. 동사가 개발한 레이저 리플로우는 PCB 하단에서 레이저를 조사하여 솔더 범프를 녹여 붙이는 방식이다. 이 때, 상부에서 열이나 압력을 가하지 않아 민감한 로직칩과 HBM을 보호하면서, 인터포저와 기판간의 접합을 2 ~ 3초만에 완료할 수 있다는 장점이 있다.

범프 이외에 다양한 접합재나 기판 재질의 국소적 녹임/융착/합착을 통해 본딩까지 가능한 레이저 본더

즉, 칩에 영향을 주지 않으면서 본딩 공정을 수행할 수 있다는 장점이 있다. 여기서 더 나아간 것이 레이저 본더이다. 기존의 레이저 리플로우 장비가 범프를 녹이는 역할에만 한정되었다고 한다면, 레이저 본더는 범프 이외에 다양한 접합재나 기판 재질의 국소적 녹임/융착/합착을 통해 본딩 과정까지의 수행이 가능하다.

반도체의 미세화가 지속되고, 3D 적층 공정 도입되면서, 기존 리플로우 공정에서는 문제가 되지 않던 웨이퍼 휨(Warpage) 현상 등이 점점 문제가 되고 있다. 이에 따라, 국소적으로 레이저를 이용해 본딩을 할 수 있는 레이저 본더의 필요성은 점차 커질 것으로 예상한다.

시장규모

디스펜서 – 1조원

레이저본 – 3조원

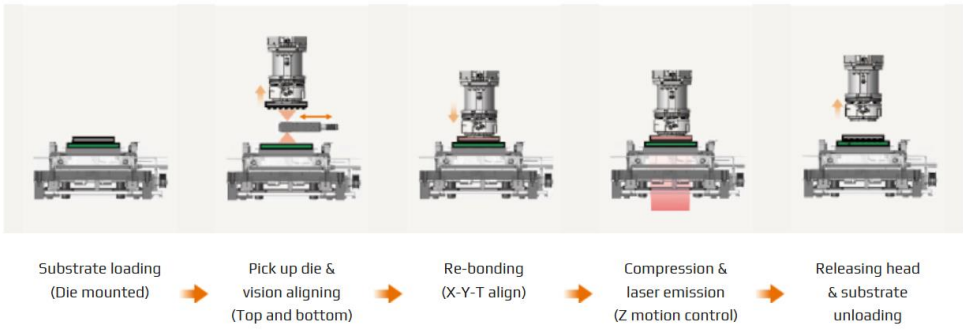
레이저본더 시장은 본격적으로 상용화된다면, 현재의 TC본더 시장과 경쟁하게 될 것으로 예상된다. 동사의 기존 디스펜서 장비 시장이 1조원 규모인 것과 비교해서, 레이저 본더 장비의 시장 규모는 3조원에 달할 것으로 예상한다.

현재 레이저 본더 장비가 본격적으로 칩 양산에 사용되고 있는 것은 아니지만, 디스펜서 장비 시장이 1조원 규모인 것에 반해, 레이저 본더 장비의 규모는 3조원에 달할 것으로 예상된다.

기존 디스펜서 장비와 비교해서 수 배이상 비싼 레이저 본더 장비

레이저 본더 장비는 동사가 기존에 납품하고 있는 레거시 디스펜서와 어드밴스드 디스펜서와 비교해서 수 배 이상 비싼 것으로 추정되어, 레이저 본더 장비가 본격적으로 납품된다면, 본격적인 시장 성장이 기대된다.

그림 6. **프로텍 레이저 본더 장비 작동 과정**



자료:프로텍, 대신증권 Research Center

신규장비인 레이저 본더의 대규모 양산을 기다리며

24년 동사의 주력 매출은 디스펜서 및 레이저 리플로우에서 발생.

동사의 매출은 24년 기준으로 디스펜서 및 레이저 리플로우 장비 65%, 공압실린더 등 17%, 프로브카드 12% 기타 5%로 구성되어 있다. 주력 제품인 디스펜서 및 레이저 리플로우 장비는 개별 매출이며, 지분 40%를 보유한 프로브카드 사업을 영위하는 피엠티를 제외하고는 100% 자회사에서 매출이 발생하고 있다. 주력 제품인 디스펜서 장비는 반도체 본딩과정 중 언더필 과정에 사용된다. 언더필은 칩과 기판 혹은 칩과 인터포져를 연결하는 과정에서 생기는 공백을 메꿔주는 과정에 사용된다. 기존 레거시 공정뿐아니라 2.5D 패키징 등 어드밴스드 공정에서도 사용된다. 반도체 레거시 시장의 부진은 지속되나, 어드밴스드 시장이 지속적으로 성장함에 따라 ASP 상승 효과 등으로 24년 디스펜서 및 레이저 리플로우 부문의 매출액 1,310 억원(+ YoY 21.6%), 영업이익 218억원(+ 1.8%)으로 회복세를 기록 중에 있다.

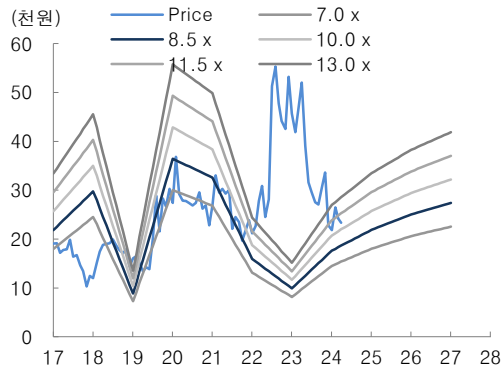
24년 대규모 적자를 기록했던 주요 자회사 피엠티의 적자폭 축소 전망

24년 주요 프로브카드 사업을 영위하는 주요 자회사 피엠티가 131억원의 대규모 영업적자를 기록하면서, 연결기준 부진한 실적을 기록하였다. 피엠티의 대규모 적자는 주요 고객사향 2D 낸드 프로브카드의 납품 지연에 따른 것으로 25년 2분기에서 3분기 사이에 퀄테스트를 통과할 것으로 기대된다. 피엠티의 영업적자 폭 축소와 기존 디스펜서 시장의 성장에 따라 25년 매출액 1,764억원(+YoY 3.6%), 영업이익 258억원(+ 92.5 %)을 전망한다.

신규 장비 레이저 본더의 대량 양산여부에 따라 향후, 동사 주가 향방이 정해질 것.

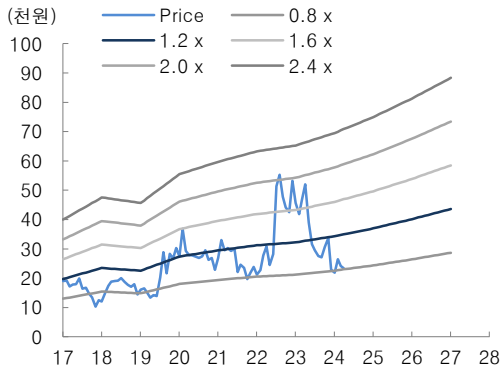
향후 동사의 주가 향방은 신규 장비인 레이저 본더 시장의 대량 양산여부에 따라 정해질 것으로 예상한다. 동사의 레이저 본더는 24년 글로벌 주요 반도체 파운드리 회사향으로 납품된 바 있다. 반도체의 미세화와 적층이라는 공정 기술 트렌드를 고려한다면, 레이저 기반 기술 장비에 대한 필요성은 점차 커질 것으로 예상한다. 대량 양산 시점을 전망하기는 어려우나, 동사의 10년 평균 PER이 12배 였던 점을 고려하면, 25년 P/E F 9.4배는 부담스럽지 않은 수준에 있다.

그림 7. **프로텍 PER 밴드**



자료: 프로텍, 대신증권 Research Center

그림 8. **프로텍 PBR 밴드**



자료: 프로텍, 대신증권 Research Center

그림 9. **프로텍 역사적 주가추이**

자료: 프로텍, 대신증권 Research Center

재무제표

포괄손익계산서 (단위: 억원)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	1,988	1,561	1,702	1,764	1,958
매출원가	1,204	1,113	1,310	1,261	1,371
매출총이익	784	447	392	503	587
판매비와관리비	183	273	258	245	264
영업이익	601	174	134	258	323
영업이익률	30.2	11.2	7.8	14.6	16.5
EBITDA	625	250	209	333	399
영업외손익	-41	46	67	44	40
관계기업손익	-20	0	0	0	0
금융수익	18	31	30	11	11
외환관련이익	73	51	49	49	49
금융비용	-4	-12	-17	-21	-25
외환관련손실	0	0	0	0	0
기타	-35	27	54	54	54
법인세비용차감전순손익	560	220	200	301	363
법인세비용	-137	-49	-72	-66	-80
계속사업순손익	423	171	128	235	283
중단사업순손익	0	0	0	0	0
당기순이익	423	171	128	235	283
당기순이익률	21.3	11.0	7.5	13.3	14.5
비지배지분순이익	1	-35	0	0	0
지배지분순이익	422	206	128	235	283
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	15	-15	16	-16	16
포괄순이익	438	155	144	219	300
비지배지분포괄이익	1	-40	0	0	0
지배지분포괄이익	437	195	144	219	300

재무상태표 (단위: 억원)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
유동자산	2,144	2,281	2,460	2,769	3,143
현금및현금성자산	606	819	915	1,189	1,450
매출채권 및 기타채권	544	358	389	402	444
재고자산	502	570	622	644	715
기타유동자산	493	534	534	534	534
비유동자산	1,318	1,342	1,349	1,356	1,365
유형자산	1,174	1,198	1,209	1,219	1,229
관계기업투자금	0	0	0	0	0
기타비유동자산	144	144	140	137	136
자산총계	3,462	3,623	3,809	4,125	4,508
유동부채	404	411	453	508	577
매입채무 및 기타채무	176	174	180	182	190
차입금	91	160	231	302	373
유동성채무	4	2	0	0	0
기타유동부채	133	75	42	24	13
비유동부채	26	69	112	155	198
차입금	0	45	90	135	180
전환증권	0	0	0	0	0
기타비유동부채	26	24	22	20	18
부채총계	430	479	564	663	775
지배지분	2,696	2,856	2,947	3,145	3,391
자본금	55	55	55	55	55
자본잉여금	160	162	162	162	162
이익잉여금	2,828	2,987	3,080	3,279	3,526
기타자본변동	-347	-348	-349	-350	-352
비지배지분	336	288	297	317	342
자본총계	3,032	3,144	3,244	3,462	3,733
순차입금	-988	-1,119	-1,102	-1,259	-1,404

Valuation 지표 (단위: 원, 배, %)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
EPS	4,686	2,290	1,424	2,613	3,148
PER	4.5	19.9	15.3	9.4	7.8
BPS	24,506	25,963	26,791	28,591	30,828
PBR	0.9	1.8	0.8	0.8	0.7
EBITDAPS	5,678	2,275	1,899	3,028	3,627
EV/EBITDA	2.7	16.7	7.9	4.5	3.5
SPS	18,070	14,188	15,473	16,036	17,800
PSR	1.2	3.2	1.4	1.4	1.2
CFPS	6,595	2,996	2,808	3,762	4,357
DPS	500	400	400	400	400

재무비율 (단위: 원, 배, %)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
성장성					
매출액 증가율	14.2	-21.5	9.1	3.6	11.0
영업이익 증가율	19.3	-71.0	-23.4	92.8	25.4
순이익 증가율	-10.2	-59.6	-25.0	83.5	20.5
수익성					
ROIC	25.4	6.5	4.0	9.1	10.9
ROA	19.0	4.9	3.6	6.5	7.5
ROE	16.2	7.4	4.4	7.7	8.7
안정성					
부채비율	14.2	15.2	17.4	19.1	20.7
순차입금비율	-32.6	-35.6	-34.0	-36.4	-37.6
이자보상배율	711.4	34.3	13.7	19.5	19.4

현금흐름표 (단위: 억원)

	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
영업활동 현금흐름	468	259	61	212	188
당기순이익	423	171	128	235	283
비현금항목의 가감	303	159	181	179	196
감가상각비	24	76	75	76	76
외환손익	49	6	-29	-29	-29
지분법평가손익	0	0	0	0	0
기타	230	76	135	133	150
자산부채의 증감	-100	21	-167	-123	-196
기타현금흐름	-157	-91	-81	-79	-96
투자활동 현금흐름	-40	-115	-79	-79	-79
투자자산	-54	-33	0	0	0
유형자산	-38	-79	-79	-79	-79
기타	51	-3	0	0	0
재무활동 현금흐름	-246	74	73	75	75
단기차입금	-1	71	71	71	71
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	45	45	45	45
유상증자	0	0	0	0	0
현금배당	-39	-37	-36	-36	-36
기타	-206	-5	-7	-5	-5
현금의 증감	157	213	97	273	261
기초 현금	449	606	819	915	1,189
기말 현금	606	819	915	1,189	1,450
NOPLAT	453	135	85	201	252
FCF	432	129	82	197	249

자료: 프로텍, 대신증권 Research Center

[Compliance Notice]

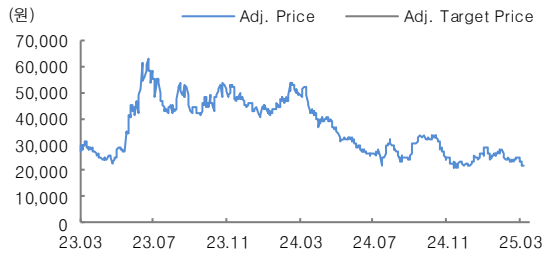
금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자:박장욱)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

[투자의견 및 목표주가 변경 내용]

프로텍(053610) 투자의견 및 목표주가 변경 내용



제시일자	25.04.03
투자의견	
목표주가	
괴리율(평균,%)	
괴리율(최대/최소,%)	
제시일자	
투자의견	
목표주가	
괴리율(평균,%)	
괴리율(최대/최소,%)	
제시일자	
투자의견	
목표주가	
괴리율(평균,%)	
괴리율(최대/최소,%)	
제시일자	00.06.29
투자의견	
목표주가	
괴리율(평균,%)	
괴리율(최대/최소,%)	

투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항(기준일자:20250331)

구분	Buy(매수)	Marketperform(중	Underperform(매도)
비율	92.5%	7.5%	0.0%

산업 투자의견

- Overweight(비중확대)
  : 향후 6개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 초과 상승 예상
- Neutral(중립)
  : 향후 6개월간 업종지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 예상
- Underweight(비중축소)
  : 향후 6개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 하회 예상

기업 투자의견

- Buy(매수)
  : 향후 6개월간 시장수익률 대비 10%p 이상 주가 상승 예상
- Marketperform(시장수익률)
  : 향후 6개월간 시장수익률 대비 -10%p~10%p 주가 변동 예상
- Underperform(시장수익률 하회)
  : 향후 6개월간 시장수익률 대비 10%p 이상 주가 하락 예상